

证券代码：002008

证券简称：大族激光

大族激光科技产业集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2025005

投资者关系 活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议） <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动
参与单位名称 及人员姓名	交银施罗德（5月6日） 摩根士丹利策略会（5月7日） 申万宏源策略会（5月7日） 华创证券策略会（5月7日） 国海证券策略会（5月8日） 招商证券策略会（5月8日） 财通证券策略会（5月9日） 大成基金（5月13日） 美银美林策略会（5月13日） 花旗银行策略会（5月14日） 中金公司（5月15日） 长城基金（5月16日） 路博迈基金（5月19日） 东方证券（5月20日） 淡水泉（5月21日） 中邮基金（5月22日） 国金证券（5月22日） 华福证券（5月23日） 摩根士丹利（5月26日） UBS（5月27日） 天风证券（5月27日） 中信建投（5月28日） 国盛证券策略会（5月29日）
时间	2025年5月6日~2025年5月29日
地点	公司会议室 深圳福田香格里拉大酒店 深圳好日子皇冠假日酒店 上海浦东香格里拉大酒店 上海凯宾斯基大酒店 北京天泰宾馆

	<p>杭州钱江新城万豪酒店</p> <p>深圳四季酒店</p> <p>香港四季酒店</p> <p>宁波香格里拉大酒店</p>
上市公司接待人员姓名	<p>管理与决策委员会副主任、董事会秘书 杜永刚</p> <p>证券事务代表 王琳</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司经营情况</p> <p>今年以来,随着下游行业需求的逐渐恢复,公司经营情况逐步改善。2025年第一季度公司实现营业收入 29.44 亿元,同比增长 10.84%;实现净利润 1.63 亿元,同比下降 83.47%,净利润下降主要由于上年同期存在处置大族思特股权产生非经常性损益约 8.9 亿元;扣除非经常性损益的净利润 0.72 亿元,同比增长 1,388.37%。净利润下降主要由于上年同期存在处置持有的大族思特公司股权对归属于上市公司股东的净利润影响约 8.90 亿元。</p> <p>二、公司 PCB 业务经营情况</p> <p>公司控股子公司大族数控(股票代码:301200)2025 年第一季度实现营业收入 9.59 亿元,同比增长 27.89%;实现净利润 1.17 亿元,同比增长 83.60%;扣除非经常性损益的净利润 1.08 亿元,同比增长 90.14%。随着 AI 产业链服务器、高速交换机等基础设施需求爆发,叠加消费电子市场复苏,PCB 专用加工设备市场需求快速反弹。公司针对不同细分市场开发创新产品,并实施专业化的整体解决方案布局,从 PCB 产品功能最优品质及成本效益出发,突破传统工艺技术瓶颈,提升产能和产品品质,赋能 PCB 产业快速增长及技术升级,各类产品营收取得较大幅度增长。</p> <p>三、公司海外布局发展情况</p> <p>当前,制造业供应链产地已经呈现多元化的发展趋势,东南亚地区设备需求呈明显上升趋势,公司正大力扩充海外研发销售团队人员,紧跟大客户的步伐,抓住供应链多元化带来的市场机会。在 PCB 海外市场方面,由于国际电子终端品牌加速供应链多元化,泰国、越南等东南亚国家 PCB 产业投资项目纷纷投产,预测未来几年的复合成长率将超过中国大陆。随着产业</p>

链的重构，美国、欧洲等地区为服务当地半导体产业发展，将全新构建当地的供应体系，其 IC 封装基板未来五年的复合增长率分别高达 18.3% 及 40.6%。

四、通用工业激光加工设备市场复苏情况

随着激光切割行业竞争激烈，市场格局日新月异。面对外部复杂环境，公司坚持研发创新，紧密围绕客户及市场需求，不断优化升级产品；坚持爆品打造，实现产品的大规模市场推广与销售放量；同时，严格坚守质量底线，坚持以质量为本。公司自主研发的三维五轴切割头取得突破，首年销售额突破 5,000 万，实现了广泛的国产替代，普遍应用于汽车行业热成型加工领域。公司推出了全球首台 150KW 超高功率切割机，扩大公司在高端领域的市场影响力。与浙江鼎力、东南网架、中国石油、爱玛科技等客户达成合作，在厚板切割效率、坡口特殊加工工艺等关键技术及超高功率激光切割工艺上持续取得进步。另一方面，根据市场需求，加大对中低端市场的覆盖和拓展，高功率激光切割设备整体市占率稳步提升。

五、公司当下市场竞争力与未来发展

公司下游包括消费电子、PCB、新能源、半导体等行业，与宏观经济的整体运行密切相关，目前全球经济仍处于周期性波动当中。公司将持续落实公司“基础器件技术领先，行业装备深耕应用”的发展战略，持续加大对基础器件以及行业专用设备业务的研发和投入，深耕细分行业，做大做强相关产业，不断强化和确立公司在相关产品市场的主导地位，推动公司业务实现持续高质量增长。

六、公司回购完成情况

公司 2025 年 2 月 6 日已披露《关于回购公司股份方案实施完成暨股份变动的公告》，截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 22,589,592 股，占公司总股本的比例为 2.15%，支付的资金总额为人民币 500,244,727.76 元（不含交易费用）。本次回购已实施完毕，实际回购股份时间区间为 2024 年 2 月 6 日至 2025 年 1 月 10 日。

公司 2025 年 4 月 3 日已披露《关于变更回购股份用途并注销的公告》，

	<p>为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股权益，进一步增强投资者信心，根据公司实际经营情况，结合公司整体战略规划、价值持续增长等因素综合考量，公司股份回购专户中的 22,589,592 股，拟由原计划“用于后续实施员工持股计划或股权激励”及“用于维护公司价值及股东权益所必需（出售）”变更为“用于注销以减少注册资本”。</p> <p>七、公司质押情况</p> <p>目前，公司实际控制人及控股股东持有股份质押比例为 75.33%。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2025 年 5 月 29 日